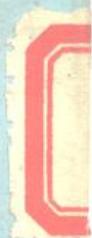


21世紀に勝ち残る 技術予測100

青柳 全一著



79.2
312

21世紀に勝ち残る 技術予測100

青柳 全一著

日刊工業新聞社

著者略歴

青柳 全（あおやぎ たもつ）

宮城県仙台市に生まれる。

昭和20年宮城県工業学校卒業。昭和23年仙台工専（現・東北大学工学部）卒業、昭和26年東北大学法医学部卒業。佛日立製作所化工部長、日立化成工業営業本部専務部長、副技師長、佛日立化成ビジネスリサーチ取締役・主幹、中小企業診断士、日本経営士会経営士。著書は、『創造型商品開発のノウハウ』（日刊工業新聞社）、『先端技術をどう読むか』（同）、『文科系にもわかる先端技術情報』（実業之日本社）、『新製品開発の進め方』（日本実業出版社）、『エレクトロニクスをどう読むか』（日刊工業新聞社）、『先端技術を英語で読む』（ジャパンタイムズ社）、『100倍以上に成長する産業』（日本工業新聞社）、『新素材をどう読むか』（日刊工業新聞社）、『新通信革命とニューメディア』（P.H.P研究所）、『10年後の日本経済』（日本文芸社）、『世界先端技術戦争』（日本工業新聞社）、『異分野技術をどう読むか』（日刊工業新聞社）『ハイテクマーケット100兆円』（日本工業新聞社）

21世紀に勝ち残る 技術予測100

NDC 509

昭和60年12月20日 初版 1刷発行

◎著者 青 柳 全

発行者 大久保 健児

発行所 日刊工業新聞社

東京都千代田区九段北一丁目8番10号

（郵便番号 102）

電話 東京（263）2311（大代表）

振替 口座 東京 9-186076

印刷所 後楽印刷株式会社

製本所 飯塚製本所

落丁・乱丁本はお取替えいたします

（定価は、カバーに）
（表示しております）

ISBN4-526-01971-2 C3034

はしがき

いよいよ八〇年代後半に突入し、二〇〇〇年を指呼の間に望むようになった。九〇年代から二〇〇〇年代にかけて、時代のトリガーテchniqueとなりうるものは、果たして、どのような技術であろうか。

技術開発の第一線に在る技術者は勿論、ビジネスマンにとっても、是非とも知りたいところである。

だが、「先きを読む」ことは、技術予測においても、まことに難しい。すでに、萌芽段階を脱し、発展段階に在る技術については、その将来性について、ある程度、見当がつこう。だが、ロングランでみた場合、どのような技術でも、不死身とはいえない。必ず、次世代技術に、とつて替られる運命にある。それは、次の時代のニーズが、現在とは違つてくるからである。

次世代ニーズに対応できる技術は、現在技術の延長線上にエスカレートしたものもあるうが、多くは、イノベーションが求められる。すなわち、現在での「不可能」を「可能」にもつていくイノベーションである。

とはいって、イノベーションが、ある日、突然出現するとは限らず、すでに、萌芽胎動している技術

も少なくない。問題は、断層を超えて、洞察し得るか、どうかにある。

本書は、そうした視点から、未来技術をとらえてみた。そして、数多くの可能性の中から、特に、

技術進歩への貢献度、市場形成度の高い技術について、一〇〇を選んだ。

果たして、これらの一〇〇未来技術が、次世代、次々世代に、大きく開花するかどうかは、神のみが知ろう。

人間の予見には、夢がつきものであるが、本書は、極力、Sサイエンス・ファイク・ファイション、Fファンタジー・ファンタション、Tトロジードラマ、Fファンタジーフィクションを排し

たつもりである。

拙筆において、本書出版に御尽力いただいた日刊工業新聞社関係者諸氏、浮奮に協力してくれた荊妻、そして、その友人に感謝の意を表したい。

一九八五年 晩秋

著者

はしがき

I エレクトロニクス技術

- | | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------|----|
| 1 100Mビット・超々LSIへの挑戦 | 2 | 12 1000年に100万の知能ロボット大団 | 39 |
| 2 三次元ICによる多機能素子 | 8 | 13 新製品開発に威力を發揮する三次元CAD/C | |
| 3 アモルファス・シリコンによる大面积IC | 10 | AMシステム | 41 |
| 4 超々LSIの実装・SOS方式 | 12 | 14 言語の壁を取外す自動翻訳システム | 44 |
| 5 超格子素子による超高速論理素子 | 15 | 15 万国語同時通訳機はいつ実現するか | 49 |
| 6 超電導素子による超高速論理素子 | 18 | 16 多彩な展開をみせる未来電話機 | 52 |
| 7 シリコンを超える未来素子『分子ダイオード、バイオチップ』 | 20 | 17 画面を五倍鮮明にする高品位テレビ | 55 |
| 8 画像処理に威力を発揮するデータフロー素子 | 25 | 18 ホーム映画劇場『壁掛家庭用テレビ』 | 57 |
| 9 非ノイマン型コンピュータ | 27 | 19 夢の三次元立体テレビ | 60 |
| 10 超記録密度の光磁気ディスク、光化学ホールバルニンク・メモリ | 31 | 20 レンズレス未来電子カメラ | 64 |
| 11 超磁気記録の垂直プロップホライン・メモリ | 35 | 21 ワードプロセッサとファクシミリのハイブリッ | |
| ド伝送『ミックスモード』 | 66 | | |
| 12 次世代ビデオテックス・サービスのVRS | 68 | | |

2 オプトエレクトロニクス技術

- 24 次世代・光ファイバー通信 74
- 25 光ICの原型“光増幅素子” 77
- 26 宇宙光通信システム 80
- 27 万能ツールのレーザ加工機 82

3 代替エネルギー技術

- 32 レーザによるウラン濃縮 96
- 33 原子力発電を実現する多目的高温ガス炉 101
- 34 ウランを100倍活用できる高速増殖炉 99
- 35 究極エネルギーの核融合炉 106
- 36 核融合とMHD発電の複合化 113
- 37 新しい石炭利用技術 116
- 38 大面積のアモルファス・太陽電池による太陽光 116

発電

- 39 全光域活用の複合型ソーラーシステム 125
- 40 水素エネルギー利用技術の大衆化 128
- 41 高温岩体発電による地熱エネルギー利用 131
- 42 ローカル発電に威力を発揮する波力発電方式 133
- 43 海洋温度差・濃度差発電方式 136
- 44 黒潮を巨大エネルギー化する潮流発電 138

4 省エネルギー技術

45 エネルギーのカンツメ	142	46 ヒートパイプによる長距離エネルギー搬送技術	146	47 モーター革命を演出する新型モーター	149	48 D/A変換に威力を發揮する静電誘導サイリス	154	49 無騒音・省エネ型未来冷凍方式〃磁気冷凍シス	158	50 都市内発電の可能な高効率燃料電池発電シス	155		
51 1/2に小型化できる超電導発電機	158	52 超電導電力貯蔵システム	163	53 送電損失ゼロの超電導送電	165	54 DNA塩基配列解析技術	168	55 遺伝子組換え生産を100倍効率化する菌体外	170	56 C ₆ 植物からC ₄ 植物への変換による作物10倍大	172	57 植物改良に挑戦する細胞融合技術	177
58 有用物質の細胞大量培養技術	180	59 バイオリアクター利用の化学工業革命	187	60 酶素技術によるバイオマス利用	187	61 バイテク利用の汚泥発電システム	187	62 人工酵素へのアプローチ	194	190	184		

6 ライフサイエンス

63 生存率八〇%以上を実現するBRM系制ガン剤

198

64 携帯型・埋込型人工心臓

65 携帯型人工すい臓

207

205

66 人工心臓
67 人工心臓・人工血管用抗血栓材料
68 身体障害者への朗報、電子眼・耳

209

7 宇宙利用技術

69 マルチビーム衛星通信システム

70 直接衛星放送用平面アンテナ

219

71 移動体通信の極「ポケット電話」

216

72 宇宙ロケットの大型化

223

73 国産大型ロケット・H-II型

226

74 宇宙開拓期便のOTV

229

75 未来宇宙エンジン「イオンエンジン」とは
76 宇宙基地の建設
77 宇宙工場生産
78 宇宙発電衛星／ソーラーパワーサテライトと
宇宙パワースタンド
232
236
232
236
240
230

213 211

8 海洋利用技術

80 79 二〇〇〇メートル深海底石油資源への挑戦
海底資源の宝庫、マンガン団塊の採集

246

244
81 新資源の熱水鉱とコバルトクラストの探鉱と採

集
249

9

- 82 海水から原子力燃料を回収 251
 83 六〇〇〇メートル級の深海潜水船 253
 84 新しい国づくり『海上プラットフォーム、人工島、海上都市』 255

未来交通技術

- 86 電気自動車を実現する新型バッテリー 262
 87 コンピュータ・交通整理の道路管制誘導システム 266

10

新素材技術

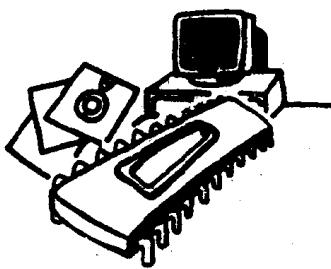
- | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| 91 常温で発現する超電導材料 | 278 | 97 ケーブル重量を十分の一にするプラスチック導電ケーブル | 296 |
| 92 五〇テスラ超臨界磁界の超電導材 | 281 | 98 ケブラーを上まわる超繊維材料 | 298 |
| 93 未来変圧器はアモルファス鉄心変圧器 | 282 | 99 宇宙、航空に活躍する先端複合材料 | 301 |
| 94 クルマの革命『セラミックエンジン』 | 285 | 100 分子レベルでのハイブリッド材料 | 305 |
| 95 ニューダイヤモンド | 290 | | |
| 96 未来化学『C ₆₀ 化学』 | 293 | | |

- 88 未来交通機関・超電導磁気浮上列車 272
 89 未来航空機はどうなる? 272
 90 船革命を実現する超電導電磁推進船 268

- 85 マリーンランチング計画 258
 86 島、海上都市』 255

1

エレクトロニクス技術



I —100Mビット・超々LSIへの挑戦

〔実用化 一九九五—一九九八〕

現在の商用LSIの最高は一メガ(M)ビットである。1Mビット・LSI・RAMとは、数ミリ角のシリコン・チップ上に、約200万個相当のパツツが形成され、1と0のデジタル信号を100万4000記憶することができる。アルファベット文字なら一二万八〇〇〇字分である。

エレクトロニクスの能力は五年で10倍、十年で100倍アップすると予測されるが、エレクトロニクスの能力には、記憶能力、演算能力、処理能力、さらに、非ノイマン型になれば、バターン認識能力、推論能力、問題解決能力がプラスされよう。LSIは、記憶能力のカテゴリに入る。LSI記憶能力アップのバターンを簡単に示すならば、

現在……1Mビット

五年後……16Mビット

十年後……64と一二八Mビット

のようになるだろう。前述のアルファベット文字の換算でいえば、一六Mビット級で、二〇四万八〇〇〇字、一二八Mビット級で、なんと、一六三八万四〇〇〇字となってくる。一六〇〇万字とは、コンサインズ英和辞書の何冊分になるか計算されたい。

問題は、この10倍、100倍のシナリオがその通りにいくか、であるが、結論的にいえば、「可能」と予言できる。

とはいって、その道程にはいくつかの技術的壁があり、ブレークスルーしなければならない。その第一の壁は、超微細回路への挑戦である。

今、一Mビット・LSI（以下RAMの場合はRAMを省略する）は、数ミリ角のスペースに、二〇〇万個相当のペーツ（トランジスタ、ダイオード、抵抗、コンデンサ、導体など）が形成されてい、る、と述べたが、では、一個のペーツのサイズはどの程度になるか。〇・九七ミクロンである。われわれの毛髪径の一〇〇～一三〇ミクロン、バクテリアの五～一〇ミクロンと比較して、いかに超微細か理解がいくだろう。LSIがより高集積化していくと、チップ面に形成されるペーツ数とペーツ・サイズは次のように、さらに微細化していく。

記憶能力 ペーツ数 ペーツ・サイズ

四Mビット

八〇〇万個 ○・七七〇・八ミクロン

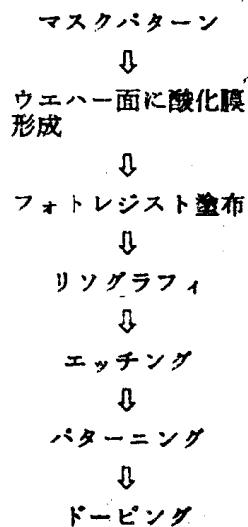
一六Mビット

三三〇〇万個 ○・五七〇・六ミクロン

もし、二次面に、高集積化していくば、六四Mビットでは○・三七〇・四ミクロン、一二八Mビットでは、実に〇・二七〇・三ミクロンと超々微細化していくことが見当つこう。

さて、そうした超微細回路をいかに形成するかである。しかも、そのコストは、集積度が四倍になつたからといって、それにスライドして四倍では、エレクトロニクスの市場規模拡大はストップするので、それ以下にしなければならない。

LSIの主要製造工程を大別すれば



となるが、線幅が微細化していくと、それぞれの工程に技術的壁が出てくる。

ます、サブミクロンの超微細寸法のリソグラフィ方式として、いくつか提案されている。

- 電子ビーム (EB) 露光法
- X線露光法
- イオンビーム (IB) 露光法

である。

このうち電子ビーム法は早くから実用化されているが、直接描画になるため、生産性が低く、装置価格も高い。これでは量産性、経済性に欠ける。一方、直接描画であるから、高価格のマスクを必要としないメリットもあり、数量の少ない試作あるいはカスタムLSIには向いているから、その分野で重用されている。そこで、次のターゲットとしてX線、イオンビームが提案された。

X線の波長は、一般光よりもはるかに短波長で、軟X線でも数十オングストロームであるから、○○一ミクロン回路幅も可能のはずである。ただし、X線露光には高輝度の線源、安定性のあるマス

表 1.1 X線回光散電子顕微鏡の開発

研究機関	X線源 (波長Å)	ターゲット (Al-K (8.34))	電子 線	実効焦点距離(μm) ×面積(μm ²)	アライメント 方	アライメント 精度 (μm)	マスク材料	ウェーハ 面 (インチ)	露光 時間 (分)	デバイス 作成
IBM	Al-K (8.34)	回転(2.3)	リング カソード	1.5	10	固析格子法/ カセット方式	Si ₃ N ₄ / SiO ₂ 膜	1~2	PMMA	60 バブル デバイス
BTL	Pd-L (4.36)	固定(4~6)	リング カソード	3	50	二重焦点法	±0.25 ポリイミド/ BN	3	DCOPA 樹脂	25 NMOS
General Instr.	Al-K (8.34)	固定(1.2)	リング カソード	10	20	光量バランス 法	マイラーナ カブト	2	COP 樹脂	60 NMOS
Texas Instr.	Al-K (8.34)	回転(1.8)	ピアス針	3	43		SIC	1.5~2	XR-79	1
Hughes	Al-K (8.34)	回転(10)	ピアス針+ 4種干渉鏡	24	光量バランス 法		カブト	2	COP	10 CMOS/ SOS
Perkin- Elmer	W-M (6.98)	回転(20)	リング カソード	15	二重焦点+干渉 法/カセット方式	±0.25 Ti	3	COP EK-88	1	MOS
VLSI共研	Al-K (8.34)	回転(10)	ピアス針	10	30	光量比較法/ カセット方式	±0.25 ポリイミド	4	PGMA EBR-1	5
・	Si-K (7.13)	回転(20)	ピアス針	6	35	光量バランス法 (透射法)	Si ₃ N ₄ / SiO ₂ / Si ₃ N ₄	2, 3	FBM, SEL-N FPM	5, 12 NMOS, SAW
武藏野通研	Si-K (7.13)	回転(20)	ピアス針	3	12	二重焦点法 TVB法	±0.1	Si ₃ N ₄	2, 4	FBM
Thomson- CSF	Cu-L (13.3)	回転(22)	リング カソード	3	21	光量バランス 法	±0.05	Si ₃ N ₄	PMMA	20 (step & repeat)

表 1.2 軟X線源の種類

軟X線源	電子線励起線源	Pd-L(4.37Å)	…BTL
		Al-K(8.34Å)	…IBM, Hughes, GI TI, VLSI
		W-M(7.0Å)	…Perkin-Elmer
		Si-K(7.13Å)	…ECL
	レーザ励起プラズマ	Cu-L(13.34Å)	…Rockwell, Thomson-CSF
		Fe100J×10%	…Battelle Mat Inst
	ガスプラズマ	Al 3J× 1%	…Naval Res Lab
		Ne(12Å)150J×2%	…Maxwell
		Kr(7Å)25J×0.33%	…MIT
	シンクロトロン放射光	スパーク放電プラズマ C(40Å)40J×4%	…IBM, MIT
		7.5 GeV	…IBM-DESY
		0.54 GeV	…Thomson-CSF-LURE
		2.5 GeV	…Stanford Univ.
		1.3 GeV	…阪大-INS

ク材料の開発が最大のポイントになる。表1-1、表1-2には、X線露光についての開発状況と線源（このうち、シンクロトロン、レーザ励起、プラズマが有望視されている）を示すが、一九八七・八九年には一応の実用域に達するものと思われる。西ドイツ・BESSY社は小型シンクロトロンの実用化のメドをつけた、と言明している。

また、LSIの製造工程においては、エッチングのドライ化、ドーピングのドライ化が進んでおり、そのドライ（乾式）化の立役者がイオンビーム（IB）である。もし、リソグラフィもIBでいければ、一つの製造装置で大半の工程を消化できる夢の半導体製造装置になり得る。

IBは、EB露光のような近接効果がほとんどないため、X線露光と同様に、非常に高い分解能をもち、○・一ミクロン以下の超微

表 1.3 イオンビーム露光装置の開発

研究機関	イオン源	集束系	マス分析系	加速電圧	スポット径	備考
Hughes Res. Lab.	Ga	1段加速レンズ	—	82mm 55kV	58pA 380Å 80pA 1000Å	撮画 イオン注入 イオンエッチング
Hughes Res. Lab.	Au-Si Pt-B Pd-Ni-B Pd-Ni-B-Au	3段レンズ	E×13	— (最大150kV)	0.12nA 3nA 1000nA 5000nA	撮画 イオン注入 イオンエッチング
Oregon Graduate Center	H+He Ar	2段アイソツュル レンズ	—	~250nm 15kV	20pA 60pA 2000Å 6500Å	SIMM用
Oregon Graduate Center	Ga In Bi	2段非対称レンズ {アイソツュルレンズ	—	— 20~60kV	—	SIMM用
大阪大基礎工学部	Au-Si Pt-Ag Pt-Ni-B	2段アイソツュル レンズ	E×13	530nm 40kV (最大70kV)	1nA ~1pA	撮画 イオン注入 イオンエッチング
Au-Pt-Sb	Ga	1段アイソツュル レンズ	—	150nm 50kV	50pA 3nA 1000Å 1μm	走査イオン エッチャング
電子技術総合研究所	Ga	1段アイソツュル レンズ	—	113nm 20kV	20pA 1000Å	SIMM用
日立中央研究所	Ga (Ga In)	1段ハイドラーーレンズ	—	— 150nm	— 2000Å	SIMM用
日本電気	Ga	1段アイソツュル レンズ	—	— 150nm	—	—
武藏野通研	Ga	2段非対称アイソ ツュルレンズ	—	355nm 34kV	0.5nA 4000Å	レジスト露光
武藏野通研	Al	—	—	—	—	Alイオン源の特性 測定

サイエンスファーラム社刊「LSIプロセステータ」